



证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

公告编号：2026-055

苏州固锔电子股份有限公司

SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD.

002079

2026 年半年度报告摘要



二〇二六年八月二十六日



一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	苏州固锔	股票代码	002079
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李莎		
办公地址	江苏省苏州市高新区通安镇华金路200 号		
电话	0512-66069609		
电子信箱	lisha@goodark.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,572,947,488.04	1,992,925,820.32	29.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,294,242.42	43,702,051.36	76.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,823,676.98	14,073,965.45	360.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-232,292,201.25	176,839,717.31	-231.36%
基本每股收益（元/股）	0.0916	0.0539	69.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0916	0.0540	69.63%
加权平均净资产收益率	2.25%	1.43%	0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,971,385,323.68	3,791,082,159.63	31.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,045,889,849.71	3,106,769,034.36	30.23%



3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		93,702		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
苏州通博电子器材有限公司	境内非国有法人	20.84%	189,350,955.00	0.00	不适用	0.00	
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	27,233,115.00	27,233,115.00	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	17,194,414.00	0.00	不适用	0.00	
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	境内非国有法人	1.05%	9,537,601.00	0.00	不适用	0.00	
易米基金—日照钢铁控股集团有限公司—易米基金元启一号单一资产管理计划	其他	0.72%	6,535,947.00	6,535,947.00	不适用	0.00	
李天虹	境内自然人	0.70%	6,318,082.00	6,318,082.00	质押	4,463,000.00	
郑文宝	境内自然人	0.67%	6,042,100.00	0.00	不适用	0.00	
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.41%	3,684,800.00	0.00	不适用	0.00	
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.36%	3,267,973.00	3,267,973.00	不适用	0.00	
财通基金—山东土地集团供应链管理有限公司—财通基金安吉 568 号单一资	其他	0.36%	3,267,973.00	3,267,973.00	不适用	0.00	



产管理计划						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之中，苏州通博电子器材有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东郑文宝通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,766,100 股；股东郭乔坡通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,923,350 股；股东王贺军通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,845,103 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

公司总部位于中国苏州，同时在新加坡设有海外研发与管理总部。生产基地分布于苏州、宿迁、成都及马来西亚，在日本及中国台湾等国家和地区布局销售网点，销售网络覆盖全球。截至 2026 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 25.73 亿元。其中，半导体业务收入 5.08 亿元，核心产品市场份额稳步增长；新材料业务收入 20.38 亿元，成为当期业绩增长主要动力。截止 2026 年 6 月 30 日，公司资产总额 49.71 亿元，负债总额 9.18 亿元，资产负债率 18.46%，始终保持财务结构稳健；现金及现金等价物余额 8.14 亿元，现金流稳定，具备充分的抗风险能力与业务扩张空间。

自成立以来，公司始终坚持自主研发、内生增长，持续加大研发投入。截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有境内专利共计 271 项，其中发明专利 101 项、实用新型专利 168 项、外观设计专利 2 项；核心研发团队稳定，技术实力行业领先。此外，2026 年上半年，公司在半导体板块荣获 AAA 级两化融合管理体系证书；2026 年 4 月，公司正式发布首份中文 ESG

报告，充分展示公司在环境管理、社会责任、公司治理领域的建设成效与实践成果，Wind 及华证 ESG 评级均评为 A 级，可持续发展能力显著提升。

公司核心业务聚焦半导体与新材料两大板块，半导体主要涉及分立器件与集成电路封测、新材料主要涉及光伏浆料研发生产，构建了“研发 - 生产 - 销售”全链条运营体系与全球化产业布局。

半导体领域，公司是国内最大的整流器生产工厂之一，深耕半导体领域三十余年，拥有完整的半导体封装测试全流程技术能力，具备多规格晶圆全流程封测能力。公司已形成 50 多个系列、7000 多个品种的产品体系，覆盖整流二极管芯片、微型桥堆、光伏旁路模块、无引脚集成电路封装、MOS、IGBT、小信号功率器件、传感器封装等品类。

2026 年上半年，公司在现有产品矩阵基础上持续迭代优化，围绕汽车电子、工业与通信、电源管理、消费电子下游市场需求，完成部分重点型号产品性能升级与衍生新品开发；各下游应用领域业务衔接顺畅，与国际知名分立器件厂商的 OEM 业务合作持续深化，订单结构不断优化，产品供货能力充分匹配客户多元化采购需求。

2026 年上半年持续优化产品结构，加快推进车规级半导体产品的客户验证、迭代改良与批量交付进程。在 2025 年已实现多家头部车企及汽车零部件厂商供应商准入的基础上，公司进一步扩充合格客户资源，推动存量准入客户订单放量，车规级产品营收占比保持稳步提升。与此同时，持续拓宽工业级产品落地应用场景，绿色能源领域业务贡献持续增强，公司高端化战略逐步由准入认证阶段迈入规模化经营阶段。

2026 年上半年“小信号产品封装与测试”募投项目建设稳步推进。公司将有序开展厂房布局规划、设备选型、采购及安装调试等各项工作。项目建设完成后将提升小信号器件在汽车、数据中心等中高端市场的渗透率。

在 2025 年国产替代、工艺技术突破、精益生产取得成效的基础上，2026 年上半年公司持续完善供应链体系，扩大国产设备与材料的导入应用规模，深化与核心供应商的战略合作，保障供应链安全稳定、自主可控。公司推动金线转铜线键合、高密度框架设计等已取得突破的关键技术实现规模化量产，同步持续开展工艺细节迭代优化；不断提升生产自动化程度，纵深推进精益生产管理。在 2025 年降本增效成果之上，进一步挖掘生产运营潜力，持续提升制造环节经营效益。

新材料领域，公司依托全资子公司苏州晶银开展光伏浆料业务，是国内首批实现银浆本土化的国际知名光伏电池导电浆料供应商。依托自身的研发与技术优势，是国内首家完成 HJT 低温浆料产业化并在全球率先实现银包铜低温浆料量产应用的企业，持续推动行业少银、无银技术升级。

全技术路线产品布局完成：已实现 TOPCon 电池用高温银浆、TOPCON 种子层银浆叠银包铜浆料、HJT 电池用低温银浆及银包铜浆料、BC 电池用银浆、高效 PERC 电池用银浆全系列产品产业化。

技术迭代持续领先：重点推进低银化、低成本浆料研发，银包铜浆料的成本进一步降低，积极研发含银量 2%-5% 的银包铜浆料，力争 2026 年下半年完成客户端的测试。



产能扩张有序推进：推进“年产太阳能电子浆料 500 吨项目”建设，项目建成后将大幅提升公司 TOPCon 与 HJT 银浆产能，进一步提升市场份额与规模效应。

苏州固锔电子股份有限公司

法定代表人：吴炫崎

2026 年 8 月 26 日